

九、申請專利範圍：

1、一種 LED 模組，其主要是由數 LED 燈、數基板、數導熱塊、數導熱元件及數固定元件所組成，該 LED 燈之一側設有一極板，另一側則為一發光二極體，該極板一側的兩端分設有電極，且電極之間乃相距有一適當距離，而發光二極體上則環設有一護框，而該導熱塊係為一具厚度且具高導熱性之金屬塊體，乃用於充當導熱媒介，以貼附在 LED 燈極板之一側而將 LED 燈作動後所發出的熱量溢散，並於該導熱塊上設有數鎖固孔，以用於經固定元件的鎖附而將導熱塊與基板結合，而導熱元件則貼附於導熱塊之另一側，其係為一具散熱效果之導熱體，其一端設有散熱鰭片，以用於將導熱元件經導熱塊所接收之熱量散出，其特徵在於：

該基板乃是一具線路之印刷電路板，其上設有數透孔，係用以嵌入 LED 燈，並於其一側設有串聯電路，用以將 LED 燈串接而使其亮度增加，且該基板上設有數穿孔，乃用於固定元件的穿設而將基板鎖固於導熱塊上，使極板介於基板與導熱塊間，形成貼密、達到強迫導熱之效果。

2、如申請專利範圍第 1 項所述的一種 LED 模組，其中，該導熱塊之寬度係等同於電極間之距離。

3、如申請專利範圍第 1 項所述的一種 LED 模組，其中，該基板透孔之內徑係略大於 LED 燈護框之外徑。

4、如申請專利範圍第 1 項所述的一種 LED 模組，其中，該基板上所設之串聯電路可依需求設為兩側。

5、如申請專利範圍第1項所述的一種LED模組，其中，該基板之材質可設為鋁。

6、如申請專利範圍第1項所述的一種LED模組，其中，該基板所設的串聯電路可依LED燈的數量延長及縮短。

7、如申請專利範圍第1項所述的一種LED模組，其中，該導熱元件可設成梯型以使得該導熱元件之一側可直接貼設於LED燈電極間。

8、如申請專利範圍第1項所述的一種LED模組，其中，該導熱元件之一端可設數散熱鰭片，以用於將導熱元件所接收之熱量散出。

9、如申請專利範圍第1項所述的一種LED模組，其中，該固定元件可為螺絲。

10、如申請專利範圍第1項所述的一種LED模組，其中，各部件間可用焊接的方式接合。